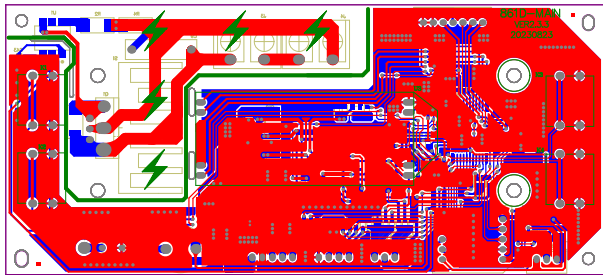



1	2	3	4	5	6	7	8
线路板名称		版本号	打印日期				
861D-Main-VER2.3.3-20230823		VER2.3.3	2024/4/10				
							
技术要求:							
1. 板材: 1.6mm厚双面环氧板							
2. 绿色阻焊剂, 白色丝印, 过孔盖油							
3. 板框、槽孔、V_CUT等以Mechanical1为准, Keepout layer 只作为禁止布线使用							
		马奎林	20230823	第10次修改	四个按键和显示屏位置移动		
更改	马奎林	20190702	第9次修改	所有按键的焊盘过孔由1.2mm改为1.3mm			
更改	殷玉龙	20170525	第8次修改	单片机改为ATMEGAL16, 按键加上拉电阻			
绘图	吴玉平	20140401	材料	双面环氧板		861DA 主板	<input type="checkbox"/> 试样 <input type="checkbox"/> 量产
审核			尺寸	68*151*1.6mm			
批准			品号	861D-Main-VER2.3.3-20230823			层: <del>Top Overlay</del> <del>Bottom Overlay</del>
1	2	3	4	5	6	7	8

技术规范	
常用层	Top Layer: 顶层铜箔线路层 (正视图) Bottom Layer: 底层铜箔线路层 (透视图) Top Overlay: 顶层丝印层 (铜层字符为正) Bottom Overlay: 底层丝印层 (铜层字符为反) Mechanical 1: 机械层 (此层的孔为非金属孔化孔) Mechanical 13: 机械层 (此层用来画3D body) Mechanical 14: 机械层 (此层用来画尺寸标注及辅助线) Multi-Layer: 多层线路层 (此层的孔为金属孔化孔) Keep-Out Layer: 禁止布线层 (此层所画的线、孔等用后删除)
板厚公差	板成品公差±10%
成品表面铜箔	常规 35um (1OZ)
导通孔 (VIA) 公差	负公差无要求, 正公差控制在+3mil (0.18mm) 以内
V-CUT (割V型槽)	V割后残留的深度为1/3板厚
阻焊层	涂敷部位应涂敷阻焊层, 除焊盘、MARK点、测试点等之外的PCB表面均需要。
技术要求	PCB加工无特殊要求一般是指: 1. 热风整平 2. 绿色阻焊剂 3. 白色丝印层, 字符清晰